

深圳佰维存储科技股份有限公司

2026年度“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告

为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，积极响应中央政治局会议关于活跃资本市场，提振投资者信心的号召，落实以投资者为本的理念，深圳佰维存储科技股份有限公司（下文简称“公司”）制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“《行动方案》”），并于2026年3月19日经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，详见公司于2026年3月20日披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

2026年半年度，公司持续评估、实施《行动方案》的具体举措，现将《行动方案》在报告期内的实施和效果评估情况报告如下：

一、聚焦核心市场，塑造主流市场一流竞争力

公司将紧抓AI技术与各行业应用场景加速融合的机遇，着力打造全面的存储解决方案组合，以满足不同AI应用场景对数据传输效率、时延、能效与尺寸规格的差异化需求。在智能移动与AI新兴端侧领域，公司致力于加速推动大容量、高性能及轻薄化存储解决方案在端侧大模型应用场景的规模化落地；公司产品已进入Meta、Google、阿里、小米、OPPO、vivo、荣耀、传音、小天才、摩托罗拉、中兴、TCL等行业知名厂商。在PC领域，公司SSD产品已经进入联想、小米、Acer、HP、华硕等国内外知名PC厂商；在国产PC领域，公司是SSD产品的主力供应商，占据优势份额。在企业级（服务器）领域，公司面向数据中心、云计算、AI服务器等高吞吐、高可靠场景，持续加大企业级存储研发投入与市场拓展力度，加深与联想等一线OEM厂商的合作，促进长期合作框架达成，并同步推进与互联网云厂商的业务合作落地。在智能汽车领域，公司已实现车规级存储产品的批量交付和规模销售，累计导入国内外40余家主流主机厂及核心Tier1供应商的供应链；其中，海外市场取得突破，已进入海外多家主流Tier1供应商的供应链体系。

二、强化研发与封测一体化，构建核心技术壁垒

公司将继续强化“研发封测一体化”战略，持续加大关键环节的研发投入，构建涵盖芯片设计、存储解决方案及先进封测的全链条垂直整合能力，以实现对新AI应用场景的快速响应、深度定制与高效交付。

在芯片设计领域，公司将加速自研主控芯片的规模化商用与市场渗透，首款国产自研eMMC主控芯片（SP1800）已在智能穿戴、智能手机、智能汽车及工业控制等多个应用领域实现规模量产与出货；UFS主控芯片已完成回片验证，预计2026年下半年导入终端客户；同时，公司布局小容量NAND Flash介质设计领域，已与国内头部代工厂达成战略合作，在24nm/19nm等节点开展中小容量SLC/MLC NAND产品开发。

在存储解决方案领域，公司将持续深化介质特性研究、固件算法开发及软硬件协同创新，着力打造全方位、多层次的存储解决方案组合，精准满足不同场景对数据传输效率、低时延、高能效比及极致尺寸规格的差异化需求。

在先进封测领域，公司通过先进封装技术打造生态链，覆盖AI硬件基础设施“存、算、运”三大核心领域：“存”是面向先进存储芯片的FOMS（扇出型存储堆叠）系列，满足大容量、高密度存储需求，公司已推出使用FOMS-R工艺的超薄LPDDR产品，该产品进展顺利，目前已经收到客户需求预测；“算”是聚焦计算与存储整合的CMC（存算芯粒）系列，适配存算合封的技术发展趋势，公司CMC产品实现10颗Chiplet集成封装，目前已完成工艺开发样品制作；“运”是主攻高速信号传输的OEC（光电共封装）系列，契合超高速互联的应用需求，公司OEC产品目前正在与客户合作开发6.4T NPO的光引擎封装，预计2026年第四季度完成研发；三大产品线可全方位响应AI时代对存（大容量存储）、算（存算合封）、运（高速信号传输）的核心诉求。

三、顺应周期，加速产能扩张和强化供应链管理，支撑业务高质量增长

为紧抓存储行业超级大周期与高成长性共振的历史性机遇，公司将坚定实施“产能扩张+技术迭代”双轮驱动战略，全面加速高质量增长：在存储器封测领域，公司将通过引进国内外设备与深度优化工艺，重点扩建面向大容量、轻薄化、高可靠产品的封测产线，精准匹配消费电子、车载电子、工业物联及服

务器等多元场景需求；在晶圆级先进封测领域，公司将全力推进项目产能爬坡建设，计划2026年底月产能达5,000片、2027年底攀升至10,000片，通过阶梯式产能释放全方位响应大容量存储、存算合封和光电共封装等核心诉求。

为保障战略规划的高效落地，公司持续高度重视供应链管理体系。在供应链层面，公司开展战略性备货，截至报告期末，存货余额181.68亿元，库存储备充足；同时，公司持续深化与全球主流存储原厂的合作，与存储原厂签署两份长期原材料采购协议，累计承诺采购金额33.608亿美元，锁定未来两年核心原材料供应资源，保障公司生产经营持续稳定。其中，企业级闪存颗粒对应承诺采购金额为18.608亿美元，为公司企业级业务拓展提供原材料保障。

四、深化全球化战略布局，稳步实施产业链整合

公司坚持全球化的发展战略，在美洲、印度与欧洲等中国以外重点市场建立本地化服务、生产交付与市场营销团队，通过与当地合作伙伴的深度协同与持续创新，快速响应本地需求并稳步提升目标市场份额。公司已构建覆盖60多个国家与地区的分销网络，服务约500家海外客户，为国际化业务扩张奠定了坚实基础。

公司与全球主要的NAND和DRAM供应商及晶圆代工厂保持长期深入合作，通过长期供应协议，确保关键材料的稳定供给以支持业务增长。作为国内获得众多CPU、SoC以及系统平台认证的企业之一，公司的核心产品进入多家全球领先品牌的合格供应商名录，显著提升了公司在全球市场的竞争力与客户信任度。

五、优化治理体系，强化规范运作

报告期内，公司治理机制有效运行，全体董事恪尽职守，独立董事在重大事项决策中进行了事前审查，充分发挥了监督与建言献策作用。报告期内，根据上海证券交易所发布的《关于落实〈上市公司治理准则〉等相关要求的通知》，结合公司实际情况，公司修订了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，主要增加了绩效薪酬占比的内容以及止付追索的内容，以进一步健全董事、高级管

理人员激励和约束机制，促进其与公司长期利益深度绑定，推动其勤勉履职、主动担当，助力公司实现可持续高质量发展。

六、重视“关键少数”履职，持续长期激励

报告期内，公司组织董事、高级管理人员进行港股上市前的合规培训，同时公司董事、高级管理人员积极参加上海证券交易所组织的培训学习；报告期内，公司及时收集、分析资本市场最新监管动态，每月不少于1次定期分享并赋能“关键少数”，以提升其合规意识及履职能力，推动公司长期稳健发展。

公司持续健全公司长效激励约束机制，绑定核心骨干与公司长远发展利益，充分激发团队积极性与创造力。报告期内，公司完成了2023年限制性股票激励计划第二个归属期（第二批次）、2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期（第二批次）、2024年限制性股票激励计划首次授予和预留授予第二个归属期的归属股份登记手续。

七、提升投资者回报，共享发展成果

公司高度重视对股东的合理回报，始终坚持将股东利益放在重要位置。一直以来，公司持续夯实主业，努力提高经营业绩和经营质量，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及日常资金使用计划，实施分红方案。2026年6月16日，公司以总股本471,566,656股为基数，每股派发现金红利0.2141元（含税），共计派发现金红利100,962,421.05元。

八、畅通投资者沟通渠道，深化价值认同

公司始终将投资者关系管理置于战略高度，致力于构建透明、高效、多元的沟通体系。通过定期举办业绩说明会、接待机构调研、开通投资者热线与邮箱、积极回复“上证e互动”问题等方式，公司主动、及时、专业地回应投资者关切，认真听取各方意见建议，确保广大投资者能够全面、准确、及时地了解公司的经营状况、发展战略及未来规划，切实维护其合法权益。2026年上半年，公司召开了2025年度现金分红说明会；面向全球投资者举办了2025年年度暨2026年第一季度中英双语业绩说明会；累计开展机构调研活动17场，其中包括惠州封测制造中心实地调研1场、东莞晶圆级先进封测制造中心实地调研3场；

由专人接听并处理投资者来电超过800次，并在“上证e互动”平台回复投资者提问170余个。

公司将持续深入落实2026年度“提质增效重回报”行动方案，切实承担起推进高质量发展水平和提升自身投资价值的主体责任，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，持续增强投资者获得感，着力促进资本市场的健康稳定发展。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2026年8月25日